



IC製程技術專輯

Access technology



IC製程技術專輯 · 楊文祿 主編

- 71** IC製程技術專輯前言
楊文祿
- 72** 氮氧化鋇與氮氧化鈦堆疊式介電層在矽與矽鍺基板上的電性研究及可靠度分析
李震謙、張廖貴術
- 88** 化劣勢為優勢進而可以量身定做的自組式鍺量子點
李佩雯
- 98** 電阻式記憶體於IC製程中的整合與發展
蕭郁蘋、林育賢
- 112** 應用標準CMOS製程實現矽基太陽能電池效率提升之研究
賴宇紳
- 123** 超高功率IC元件之製程技術開發與微縮發展
吳承炎、游信強
- 140** 三維積體電路(3D IC)製程技術與發展
林立民

企業專訪

- 12** 全方位生命安全偵測專家
氣體與火焰偵測領域的領導者—
漢威聯合股份有限公司(Honeywell)
探測器產品事業處專訪
專訪漢威聯合(Honeywell)台灣區彭寶展總經理

市場 | 觀察 | 分析

- 52** 廠商熱訊
- 67** 5代廠紛紛投入中小尺寸面板生產行列
多模多頻單晶片將成為手機主流晶片
- 68** 蘋果A9晶片代工重回三星
- 69** NAND第3季需求暢旺
正歲有望代工 Pebble智慧手錶
- 70** 低價智慧型手機暢銷連帶造福封測廠

下轉第4頁

請掃描QR條碼或
<http://qrs.ly/dd2>
以便觀看產品展示

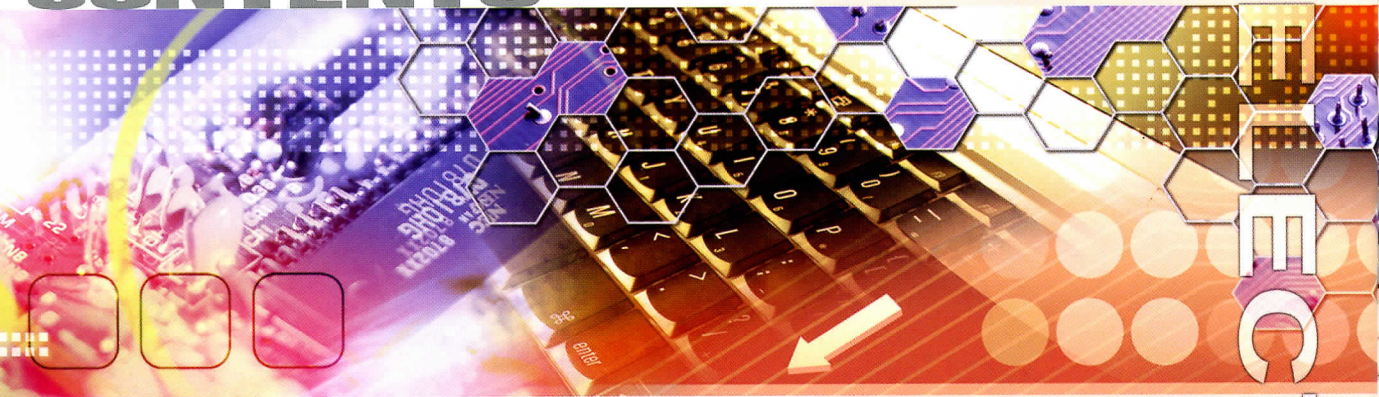


© Agilent Techno

前瞻 加

CONTENTS

The M



TRONIC MONTHLY

專題

主被動元件

- 153** 淺談用於醫學檢測的微波成像技術與系統裝置
藍祥文、洪政源、翁敏航、張守進

3D IC

- 164** 3D IC多樣化之TSV製程技術分析
許明哲、葉蔭晟、黃文隆、黃立佐、何聖明

專欄

電子材料

- 176** 石墨烯的應用前景(I)
徐欽松

技術櫥窗

- 184** 光纖在電弧閃光偵測的應用
Alek Indra

人生偶拾

- 188** 世人面對矛盾二三事
黃博治

PCB技術小百科

- 190** 軟性印刷電路板基本製程
翁敏航

本刊圖文未經同意，不得轉載或公開傳送！

社內消息

廣告部

- 33 廣告索引

發行部

- 139 日經BP社雜誌訂閱消息
193 劃撥單

編輯部

- 34 讀者意見調查表
87 2013年10月專輯主題說明
96 徵文啓事
97 2013年11月專輯主題說明
122 2013年12月專輯主題說明
192 投稿須知



各種引

TH